

FB-x26 BUMP1

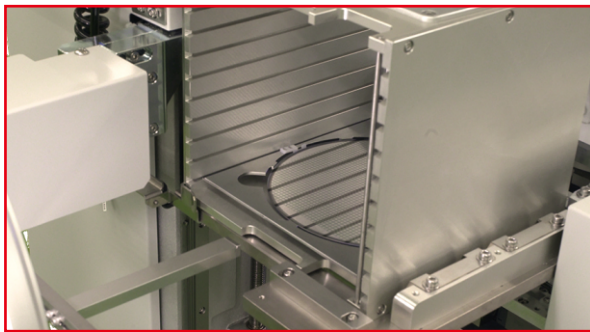
KAIJO

超声波兼用热压合（热超声键合）方式 高精度植球机
Highly Accurate Thermosonic Bump Bonder

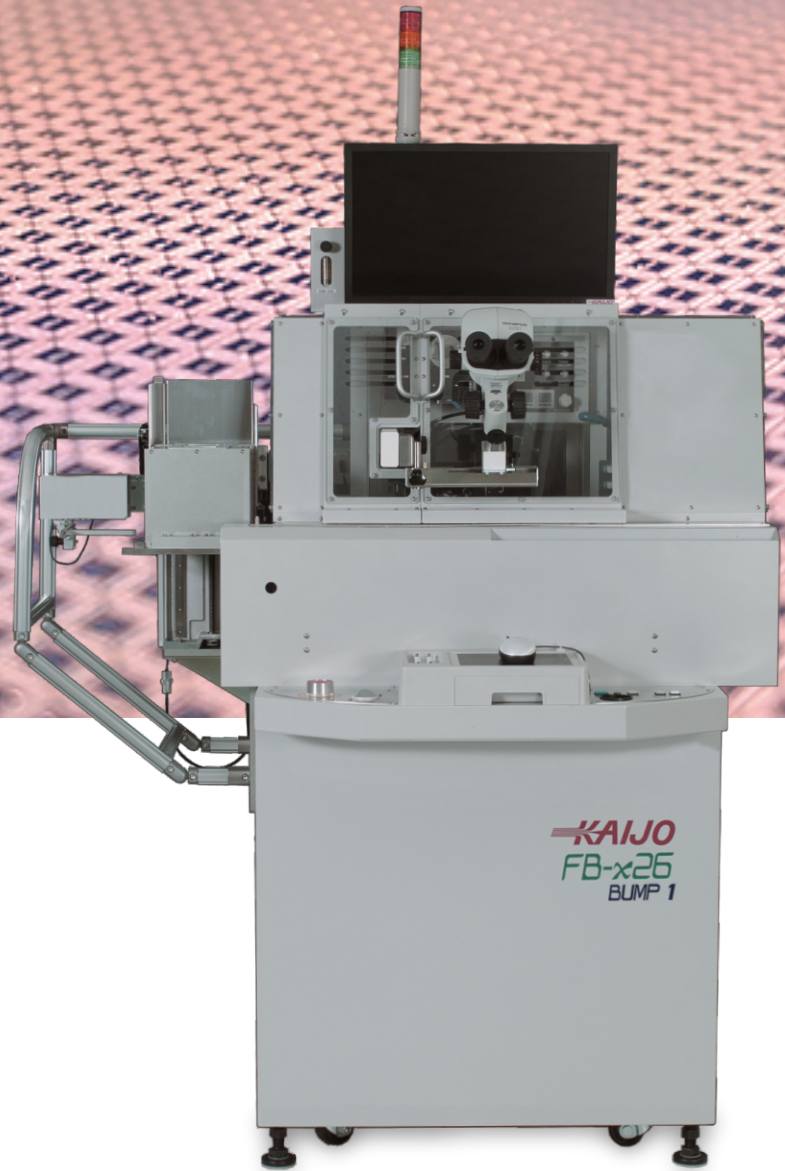


从料盒自动供料的植球机，
可对应到 6 英寸的晶圆

Bump bonder with automatic wafer
supply up to 6 inches by magazine



通过推杆收纳在料盒中的晶圆
Pusher, and wafer in the magazine



※保护罩选配规格
※Specifications with optional covers

特性 / FEATURES

- 最大可自动供给 6 英寸晶圆，可进行稳定的晶片处理
Wafers up to 6 inches can be automatically supplied, contributing to stable handling
- 提高可追溯功能和自我诊断功能，有助于品质管理和设备维护
Enhanced traceability and self-diagnosis function. Contribute to quality control and machine maintenance
- 满足不断提升的连接性和工业 4.0 的需求
SECS/GEM 作为标准配置，亦可使用 KAIJO 自有主机管理系统 KISS
Ready for the growing demand of connectivity and Industry4.0 - SECS/GEM or "KISS" (Selectable)

FB-x26 BUMP1

主要规格

焊线性能	
焊接方式	超声波热压焊接（热超声）方式
超声波振荡系统	由 PLL 输出频率自动跟踪振荡系统，单频率
焊线范围	4 英寸晶圆：直径 95mm 6 英寸晶圆：直径 145mm
重复位置精度	$3\sigma \leq 3.0\mu\text{m}^*$
植球速度	30msec/bump(Pull-Cut mode)** 40msec/bump(Fix-Cut mode)**
图像识别功能	
识别方式	可从形状识别方式（ α -eyes）和多值化相关处理方式中选择
检测速度	约 100msec/2 点（5mm 角芯片时） 约 200msec/4 点（5mm 角芯片时）
检测率	99.9% 以上 **
对应工件	
晶圆尺寸	4~6 英寸 厚度：0.2 ~ 1.0mm
载盘尺寸	宽度：170mm 长度：170mm 高度：2.0mm
料盒尺寸	宽度：176mm 长度：180mm 或 200mm 高度：170mm
外部通讯	
	SECS/GEM 搭载 KISS 搭载 (各主机软件另售或者另行咨询)
电气要求	
电源	单相 AC200V \pm 5%，50Hz/60Hz，8A ※210V, 220V, 230V, 240V, 100V 可选择 最大消耗电力：约 2.0kW
干燥压缩空气	压力：0.3 ~ 0.970MPa (3 ~ 9.9Kgf/cm ²)、ISO5 级以上 消耗量：40Liters/min 以下
真空	压力：-53.32MPa 以下 (400mm/Hg 以上)
尺寸·重量等规格	
尺寸	宽度：1,292mm 深度：1,240mm 高度：1,728mm (包括信号灯 2,030mm)
重量	约 550kg

* 不包括自校准精度
** KAIJO 规定条件下的计算值
*** Kaijo Interconnecting Service System 的略称

SPECIFICATIONS

Bondability	
Bonding method	Ultrasonic with thermocompression bonding
Oscillation system	Frequency automatic tracking by PLL. Single frequency.
Bonding area	4" wafer : Diameter 95mm 6" wafer : Diameter 145mm
Bonding Accuracy	$3\sigma \leq 3.0\mu\text{m}^*$
Bonding Time	30msec/bump(Pull-Cut mode)** 40msec/bump(Fix-Cut mode)**
Recognition System	
Recognition method	Shape recognition (α -eyes) or Multi-valued correlation processing (selectable)
Recognition time	Approx. 100msec/2 points (5mm square chip) Approx. 200msec/4 points (5mm square chip)
Detection rate	99.9% or more**
Applicable work size	
Wafer size	4"-6" Thickness : 0.2 ~ 1.0mm
Carrier boat size	Width : 170mm Length : 170mm Thickness : 2.0mm
Magazine size	Width : 176mm Length : 180mm or 200mm Height : 170mm
External interface	
	SECS / GEM available as standard KISS *** available as standard (Host software are option)
Utility	
Power	Single phase AC200V \pm 5%, 50Hz/60Hz, 8A (210V, 220V, 230V, 240V, 100V option) Maximum power consumption : Approximately 2.0kW
Dry air	Pressure : 0.3 ~ 0.970MPa (3 ~ 9.9Kgf/cm ²) ISO class 5 or more Consumption : 40Liters/min or less
Vacuum	Pressure : -53.32MPa or less (400mm/Hg or more)
Dimensions	
Width	1,292mm
Depth	1,240mm
Height	1,728mm (To top of signal lamp : 2,030mm)
Weight	Approx. 550kg

* Excluding self-teach accuracy.
** Calculated value under the conditions specified by KAIJO.
*** Kaijo Interconnecting Service System



株式会社 カイジョー / KAIJO CORPORATION
東京都羽村市栄町 3-1-5 〒205-8607
3-1-5 Sakae, Hamura, Tokyo, JAPAN 2058607

URL <https://www.kaijo.co.jp>



深圳汉华半导体科技有限公司
Shenzhen Han Hwa Semiconductor Technology Co., Ltd

地址：深圳市宝安区松岗街道潭头社区恒生工业园第四栋
电话：0755-8524 0596 传真：0755-2300 1062
邮箱：chenyp@hanhwachina.cn
网址：www.hanhwachina.cn



意见栏